

文档编号: AN2001

上海东软载波微电子有限公司

应用笔记

ES32F027X

修订历史

| 版本 | 修订日期 | 修改概要 |
|------|------------|--|
| V1.0 | 2019-1-10 | 初版 |
| V1.1 | 2020-3-19 | 1. 添加第 2 章 ES32F027x ADC 应用注意。 2. 变更 Logo。 3. Driver 及应用章节更新 |
| V1.2 | 2020-10-27 | 新增 1.9、1.10 UART/I2C/SPI FIFO 相关章节 |

地址：中国上海市龙漕路 299 号天华信息科技园 2A 楼 5 层

邮编：200235

E-mail: support@essemi.com

电话：+86-21-60910333

传真：+86-21-60914991

网址：http://www.essemi.com/

版权所有©

上海东软载波微电子有限公司

本资料内容为上海东软载波微电子有限公司在现有数据资料基础上慎重且力求准确无误编制而成，本资料中所记载的实例以正确的使用方法和标准操作为前提，使用方在应用该等实例时请充分考虑外部诸条件，上海东软载波微电子有限公司不承担或确认该等实例在使用方的适用性、适当性或完整性，上海东软载波微电子有限公司亦不对使用方因使用本资料所有内容而可能或已经带来的风险或后果承担任何法律责任。基于使本资料的内容更加完善等原因，上海东软载波微电子有限公司保留未经预告的修改权。使用方如需获得最新的产品信息，请随时用上述联系方式与上海东软载波微电子有限公司联系

目录

| | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 第 1 章 | ES32F027x 应用注意 | 4 |
| 1.1 | 开发环境..... | 4 |
| 1.2 | 寄存器写保护..... | 4 |
| 1.2.1 | IWDT 写保护..... | 4 |
| 1.2.2 | GPIO 写保护..... | 4 |
| 1.3 | 写 1 清零寄存器..... | 4 |
| 1.4 | 未使用的 GPIO 端口处理..... | 4 |
| 1.5 | 系统时钟选择..... | 5 |
| 1.5.1 | 内部高速 4MHz (默认时钟)..... | 5 |
| 1.5.2 | 外部时钟 HOSC (4~32MHz)..... | 5 |
| 1.5.3 | 内部锁相环倍频时钟 (4~48MHz, 使用 HRC 倍频)..... | 5 |
| 1.5.4 | 外部锁相环倍频时钟 (4~48MHz, 使用 HOSC 倍频)..... | 5 |
| 1.5.5 | 外部低速时钟(LOSC)..... | 6 |
| 1.6 | GPIO 模块..... | 6 |
| 1.7 | RTC 模块..... | 6 |
| 1.8 | 库函数选择..... | 6 |
| 1.9 | UART/I2C/SPI FIFO 注意事项..... | 6 |
| 1.10 | UART/I2C/SPI FIFO 中断应用范例说明..... | 7 |
| 第 2 章 | ES32F027x ADC 应用注意 | 11 |
| 2.1 | 校正的原因..... | 11 |
| 2.2 | 校准方式..... | 11 |
| 2.3 | Driver 及应用..... | 13 |

第1章 ES32F027x应用注意

1.1 开发环境

推荐用户使用 Keil5、IAR8.11 或者 iDesigner 进行固件开发。由于 Keil4 不支持 PACK 机制，故不推荐用户使用 Keil4。

1.2 寄存器写保护

为避免程序的异常导致运行错误，芯片写保护寄存器用于阻止对被保护的寄存器误操作。

系统控制单元，IWDG、GPIO 等模块支持寄存器写保护，对被保护的寄存器进行写之前需要解除写保护状态（允许写），否则无法对写保护寄存器写入。操作完成后，再使能写保护（禁止写）。库函数中均提供相应宏定义进行解除保护和使能保护。

1.2.1 IWDG写保护

默认条件下，对 IWDG_PR、IWDG_RLR 和 IWDG_WINR 的写访问操作都是受保护的，对 IWDG_KR 寄存器以字写入 0x00005555 解锁码，可以解除写保护，如果写入别的值，将会打破这个顺序，使得对寄存器的访问保护重新生效。这意味着在做重加载操作的时候（向该寄存器写入 0x0000AAAA）就属于这种情况。可以通过一个状态寄存器观察预分频器的更新、看门狗计数器的重加载或窗口值的重加载。

1.2.2 GPIO写保护

对 GPIOx_LCK 寄存器依照特定的写 / 读序列，以字方式写入 0x0001FFFF 会使 GPIOx_MOD、GPIOx_OT、GPIOx_PUD、GPIOx_AFL 和 GPIOx_AFH 进入保护。当正确的锁定序列作用于这个寄存器的位 16 时，LCK[15:0] 的值用来锁定 I/O 口的配置（在写序列期间要保持 LCK[15:0]值不变）。当锁定序列已经作用于一个端口位，该端口位的值再也不能改变直到下一次复位。

1.3 写 1 清零寄存器

有很多中断标志寄存器都是用“写 1 清零”的方式来操作。对于“写 1 清零”的寄存器，不可使用“读-修改-写”的方式来进行“写 1 清零”，否则会引起标志误清，进而产生漏中断的后果。对该类寄存器操作需要以 Word 进行写。

1.4 未使用的GPIO端口处理

系统中未使用的 GPIO 管脚建议设置为输出固定电平并悬空，若设置为输入，须加上拉或下拉电阻接到电源或地。

1.5 系统时钟选择

系统上电默认使用内部 4MHz 高速时钟(HRC)作为系统时钟，几种常用系统时钟配置：

1.5.1 内部高速 4MHz (默认时钟)

使用内部高速 RC 震荡器，频率约为 4MHz，配置如下：

1. 进入到 md_rcu.c 里面的 md_rcu_init 函数更改配置；
2. md_rcu_enable_con_hrcon(RCU);
3. md_rcu_set_cfg_sw(RCU, MD_RCU_SYSCLK_HRC);

1.5.2 外部时钟HOSC (4~32MHz)

外部高速时钟要求为 4MHz 的倍数，如：4MHz、8MHz、12MHz、16MHz、20MHz、24MHz、32MHz。

首先要确认焊接了外部高速时钟，并已知外部高速时钟的频率，假如外部高速时钟为 20MHz，则配置方式如下：

1. 进入到 md_rcu.c 里面的 md_rcu_init 函数更改配置；
2. md_rcu_enable_con_hoscon(RCU);
3. md_rcu_set_cfg_sw(RCU, MD_RCU_SYSCLK_HOSC);

1.5.3 内部锁相环倍频时钟 (4~48MHz，使用HRC倍频)

使用内部锁相环倍频时钟，选择 HRC 做为参考时钟源，需设定 PLL0 倍频系数，如：4MHz、8MHz、12MHz、16MHz、20MHz、24MHz、....、48MHz，配置如下：

1. 进入到 md_rcu.c 里面的 md_rcu_init 函数更改配置；
2. md_rcu_enable_con_hrcon(RCU);
3. md_rcu_enable_con_pll0on (RCU);
4. md_rcu_set_cfg_pllsrc(RCU, MD_RCU_PLL_SRC_HRC);
5. md_rcu_set_cfg_pllmul(RCU, X); (X 为需设定 PLL0 倍频系数);
6. md_rcu_set_cfg_sw(RCU, MD_RCU_SYSCLK_PLL0);

1.5.4 外部锁相环倍频时钟 (4~48MHz，使用HOSC倍频)

使用外部锁相环倍频时钟，选择 HOSC 做为参考时钟源时，首先要确认焊接了外部高速时钟，并已知外部高速时钟的频率，并且确认外部时钟为 4MHz，如果大于 4MHz，则需先除频，再使用 PLL0 配频系数，达到需求频率，如：4MHz、8MHz、12MHz、16MHz、20MHz、24MHz、....、48MHz，则配置方式如下：

1. 进入到 md_rcu.c 里面的 md_rcu_init 函数更改配置；
2. md_rcu_enable_con_hoscon(RCU);
3. md_rcu_enable_con_pll0on (RCU);
4. md_rcu_set_cfg_hoscddiv(RCU, 1); (依需求设定 hoscon 除频系数)
5. md_rcu_set_cfg_pllsrc(RCU, MD_RCU_PLL_SRC_HRC);

6. `md_rcu_set_cfg_pllmul(RCU, X);` (X 为需设定 PLL0 倍频系数)
7. `md_rcu_set_cfg_sw(RCU, MD_RCU_SYSCLK_PLL0);`

1.5.5 外部低速时钟(LOSC)

首先要确认焊接了外部低速时钟，配置方式如下：

1. 进入到 `md_rcu.c` 里面的 `md_rcu_init` 函数更改配置；
2. `md_rcu_enable_con_loscon(RCU);`
3. `md_rcu_set_cfg_sw(RCU, MD_RCU_SYSCLK_LOSC);`

需要注意的是，当系统时钟配置为低速时钟时(低于 1MHz)，SysTick 中断将会被迫关闭。ALD 提供的延迟类函数禁止使用。

1.6 GPIO模块

问题描述: UART reset 时，打印出来的第一个字符会有漏字或乱码现象。

解决方案: 在任何外设要设置 IO mux 时，需先切换 AF function 再切换 GPIO mode。

1.7 RTC模块

问题描述: 当 RTC 在 LOSC 系统时钟源切换至其他时钟源时，会造成无法切换的情况。

解决方案: 一开始于 `md_rcu.c` 里开启 LOSC。

1.8 库函数选择

ES32 系列芯片提供两种类型库函数 ALD 和 MD:

ALD: 提供较为完善的封装，提供更为人性化的 API，适合大部分用户；

MD: 基本上只提供寄存器位域级别的“读”、“写”接口，适合对芯片底层较为熟悉的用户。

如果用户对速度不是要求非常严格，一般情况下推荐用户使用 ALD 库。可以大大节约用户产品开发周期。

1.9 UART/I2C/SPI FIFO 注意事项

1. Tx 中断使用: 如需在中断程序中固定写入 N 笔 Data 到 Tx FIFO，必须在 Data 写入 FIFO 前确认 UART_STAT 中 TFFULL 旗标，确保 Tx FIFO 不是 Full 的状态。或是将 N 笔 Data 写入 FIFO 后才使用 ICR 清除中断。
2. Rx 中断使用: 当 Rx 触发 RFTH 中断后，使用者必须将 FIFO Data 读空或是至少读至小于于阈值，否则 RFTH 将不会再触发。

注: 下一章节会详细说明细节

1. 10 UART/I2C/SPI FIFO中断应用范例说明

- ◆ 配置 TFTH 8 触发中断，在中断程序中固定写入 8 笔 Data 到 FIFO，造成 Data 丢失的可能状况。

正常状态下当 FIFO 从 9→8 时发生中断，中断程序中再写入 8 笔 Data 到 FIFO，FIFO 可正确存储所欲传送的八字节数据，FIFO 里的 Data 不会超过 16 笔，这样的使用状况下，不会造成欲传送数据丢失状况。

如果在发生中断后，在中断程序在填入新的 8 笔 Data 的同时，有其他优先权更高的中断将之打断，就可能造成数据丢失状况。

以下举例说明：

当 FIFO 从 9→8 发生中断 1，准备写入 8 笔 Data，在写入 2 笔后 FIFO 内数据到达 10 笔，此时发生了高优先权中断导致传送暂停，但还有 6 笔数据等待传送，在执行高优先权中断时势必会发生 FIFO 从 10→9→8 又产生一次 TFTH 中断 2。等到高优先权中断执行完毕，会回到中断 1 程序中会将未传完的 6 笔 Data 传完，此时 FIFO 个数应为 9~16 之间，接续发生中断 2 后所要传送的 8 笔 data,就会发生 FIFO 数>16 状况，造成 FIFO Overflow，未传入的 Data 即丢失。

以下利用程序仿真中断程序被高优先权中断插队的状况，此范例以 md_tick_waitms(10,70) 模拟高优先权中断插队所需的运行时间：

```
char words2[8]={'Z','Z','Z','Z','Z','Z','Z','Z'};
char words3[26]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z'};
char* ptr2=words2;
char* ptr3=words3;
extern uint8_t T;
/**
 * @brief UART1_IRQHandler.
 * @param none
 * @retval none
 */
void UART1_IRQHandler(void)/* IRQ 27 */
{
    uint32_t i;
    md_uart_clear_flag_tfth(UART1);
    if(T)//First enable
    {
        T=0;
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            md_uart_send_txbuf(UART1,*ptr2);
            ptr2++;
            if(ptr2==words2+26)ptr2=words2;
        }
    }
}
```

```
}  
}  
else  
{  
for(i=0;i<8;i++)  
{  
if(i==2)  
{  
md_tick_waitms(10,70);  
}  
md_uart_send_txbuf(UART1,*ptr3);  
ptr3++;  
if(ptr3==words3+26)ptr3=words3;  
}  
}  
while(md_uart_is_active_flag_stat_tfoerr(UART1))  
{  
printf("FIFO OVERFLOW\r\n");  
while(1);  
}  
}
```

要如何避开此问题以下提供两个方式解决:

Case 1:在写入 8 笔 Data 当中，每一笔皆要去确认 FIFO 是否为 Full 的状况，这样就可以避免 FIFO overflow 状态。

```
else  
{  
for(i=0;i<8;i++)  
{  
while(md_uart_is_active_flag_stat_tffull(UART1));  
if(i==2)  
{  
md_tick_waitms(10,70);  
}  
md_uart_send_txbuf(UART1,*ptr3);  
ptr3++;  
if(ptr3==words3+26)ptr3=words3;  
}  
}
```

Case 2: 一般我们会习惯在一进中断就以 ICR 清除中断标志位，如果移到资料传送完之后才清除中断 ICR，这方法也可以避免 overflow 发生，但是主要是因为在做 ICR 时将上述所说的中断 1 与中断 2 同时清除了，其实中断 2 并无执行，如果在应用上中断 2 是必须的就应避免使用此方法。

```
void UART1_IRQHandler(void) /* IRQ 27 */
{
    uint32_t i;
    /* md_uart_clear_flag_tffh(UART1); 移到中断程序离开前清除 */
    if(T) // First enable
    {
        T=0;
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            md_uart_send_txbuf(UART1,*ptr2);
            ptr2++;
            if(ptr2==words2+26) ptr2=words2;
        }
    }
    else
    {
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            while(md_uart_is_active_flag_stat_tffull(UART1));
            if(i==2)
            {
                md_tick_waitms(10,70);
            }
            md_uart_send_txbuf(UART1,*ptr3);
            ptr3++;
            if(ptr3==words3+26) ptr3=words3;
        }
        while(md_uart_is_active_flag_stat_tfoerr(UART1))
        {
            printf("FIFO OVERFLOW\r\n");
            while(1);
        }
        md_uart_clear_flag_tffh(UART1);
    }
}
```

- ◆ 使用 RFTH 做为中断，RFTH 中断的触发条件为当 RX FIFO 内数据大于设定的阈值时产生，以 RFTH=4 为例，必须发生 FIFO 数据从 3→4 时才会触发，所以如果在 RX FIFO 触发中断后没有去将 FIFO 里的资料读空或至少拿走直到 FIFO 小于阈值，接下来将不会再触发 RFTH 中断。

以 MD 例程”UART_Rece_Send_By_IT”来看，如果将读 FIFO 这段代码拿掉，也就是当 FIFO 触发中断后并不去读 FIFO 值，接下来就不会再触发此中断，造成所谓的接收死机状态。

```
printf("UART MD Rece_Send_By_IT Example (Rx Threshold = 4)\r\n");

while(1)
{
if(uart1_interrupt==1)
{
uart1_interrupt=0;
//   ReceiveByte = md_uart_rcv(UART1);
//   printf("ReceiveByte:%d\r\n",ReceiveByte);
}
}
```

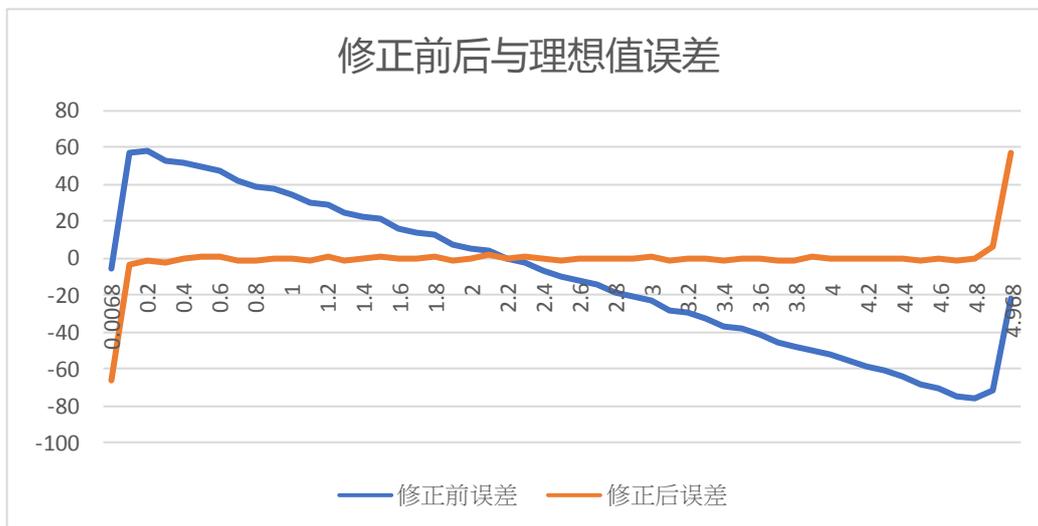
第2章 ES32F027x ADC应用注意

2.1 校正的原因

ADC 的量测结果与理想的 ADC 值有偏差的状况，主要原因有二个：

1. 前端 PGA 放大器，因为不是 rail-to-rail，因此无法量测 Vdd – Gnd 满刻度范围，可量测范围为(Vdd-150mV) – (Gnd+150mv)。
2. ES32F027X SAR ADC 内部电压与分压器件因 IC 制造过程中芯片与芯片间存在一定的差异，因为芯片内部未实现校准机制，因此输入端电压对应 ADC 数值与理想值有所偏差，必须通过软件补偿的方式，将量测所得出的数值做校准，使 ADC 趋近理想曲线。

由下图可看出修正前误差值与经过修正后误差，但从此图中都可看出前后点会有非线性的部分，这是由于我们 ADC 的 PGA 关系，导致输入 0V 并不是真实 0V，所以我们实际可使用的范围为 0.15V~4.85V 之间。



2.2 校准方式

取两个校准方式，目前取 1V 与 2V 所量测出来的值当作校准参考点，将所获得 ADC 值存入 Flash 中 (C/P 生产过程中写入)，通过线性方程式 $y=ax+b$ 的方式求出 a 与 b 的值。

a: 斜率 b: offset

1. Reference_V1: 参考点 1V
2. Reference_V2: 参考点 2V
3. Reference_V1_ADCValue: 参考点 1V 量测到的 ADC 值，存入 Flash 中
4. Reference_V2_ADCValue: 参考点 2V 量测到的 ADC 值，存入 Flash 中
5. Ideal_V1: 参考点 1V 理想 ADC 值
6. Ideal_V2: 参考点 2V 理想 ADC 值
7. Offset : 渐进线，方程式求出的 b 值
8. coefficient: 系数

根据方程式 $y = ax + b$ 求出 Offset 值(方程式中的 b 值)

offset 简易公式:

$$Offset = \frac{(Reference_V2 * Reference_V1_ADCValue - Reference_V1 * Reference_V2_ADCValue)}{(Reference_V2 - Reference_V1)}$$

参考点 1 理想值(1V 理想值):

$$Ideal_V1 = \frac{Reference_V1}{5} * 4096$$

系数:

$$coefficient = \frac{Ideal_V1}{(Reference_V1_ADCValue - Offset)}$$

校正值:

$$\text{Calibration ADC} = (\text{修正前 ADC 值} - \text{Offset}) * \text{coefficient}$$

Ex:

1. Reference_V1: 1V
2. Reference_V2: 2V
3. Reference_V1_ADCValue: 784.81
4. Reference_V2_ADCValue: 1632.81
5. Ideal_V1: 819.2
6. Ideal_V2: 1638.4
7. Offset: $(2*784.81-1*1632.81)/(2-1) = -63.19$
8. coefficient : $819.2/(784.81-(-63.19)) = 0.966$

$$\text{Result: } (784.81-(-63.19))*0.966 = 819.168$$

由结果可看出在还没校准前的值为 784.81, 校准后的值为 819.168, 接近理想值 819。

2.3 Driver及应用

◆ md_adc.c

Function 说明

1. md_adc_init(ADCx,*ADC_InitStruct,*channel) : 带入 ADC 的初始设定
2. md_adc_calibration_data(vdd,vref,*offset,*coefficient) : 带入需要的 VDD 值及 VREF 值, 三组设定值提供使用者使用, 分别为 case1: vdd_5v/vref_5v、case2: vdd_3.3v/vref_3.3v、case3:vdd_5v/vref_2.5v (存 1V/2V 参考点的值), function 会根据所选 case 从 Flash 缓存器里将对应的值取出做运算, 得到 Offset 与 Coefficient

$$Offset = \frac{(Reference_V2 * Reference_V1_ADCValue - Reference_V1 * Reference_V2_ADCValue)}{(Reference_V2 - Reference_V1)}$$

$$coefficient = \frac{Ideal_V1}{(Reference_V1_ADCValue - Offset)}$$

3. md_adc_get_data(SSx,offset,coefficient,*calibration) : 此 function 需要带入 SSx(采样 Sequence)以及 md_adc_calibration_data(vdd,vref,*offset,*coefficient)所得之 Offset 及 Coefficient, 接着将 ADC 所得到的值做运算得到校正后结果。

$$Calibration\ value = (adc_value - Offset) * coefficient$$

◆ md_adc.h

增加 adcinit struct: 可在 main.c 里给定 adc 所需的初始设定。

◆ reg_fc.h

缓存器 struct 增加三个 ADCTRIM_VDD5V_VREF5V、ADCTRIM_VDD3V3_VREF3V3、ADCTRIM_VDD5V_VREF2V5, 分别用来存 3 个 case ADC 参考点的值

bit[31:24]: 存 0xA5, 表示有值

bit[23:12]: 存 2V 参考值

bit[11:0]: 存 1V 参考值

◆ Project 名称: “ADC_Calibration_From_Flash”

设定及使用流程

Step1: md_adc_init(ADCx,*ADC_InitStruct,*channel) 带入 ADC 初始设定及取样 channel

Step2: md_adc_calibration_data(vdd,vref,*offset,*coefficient) 计算 Offset 与 Coefficient 值

vdd: 外部输入电压

vref: 参考电压

EX:

输入外部电压为 5.0V,参考电压为 2.5V 时 function 会选择 FC→ADCTRIM_VDD5V_VREF2V5

所存的值当作参考值,经过 Offset 公式计算出 offset 及 coefficient 的值。

$$\text{Offset} = (2 * 1587.19 - 1 * 3242.12) / (2 - 1) = -67.44$$

$$\text{Coefficient 公式可求出系数} : 1638.4 / (1587.19 - (-67.44)) = 0.99$$

Step3: md_adc_get_data(SSx,offset,coefficient,*calibration)

SSx: 准备取样的序列

offset: Step2 所计算出的 offset

coefficient: Step2 所计算出的 coefficient

Ex:

假设 1.5V 所量测到的值为 2417.56,经过修正后

$$\text{Calibration value} = (2417.56 - (-67.44)) * 0.99 = 2460.15$$